

ウェハー平坦度測定機  
Wafer Flatness Measuring Device  
& Sapphire Wafer

Model: Wafercom 300



**MICRO GRANITE®**

All the sensors carried in MICRO GRANITE equipment are standard goods marketed.

If you specify the characteristics to be inspected and the sensor which a customer needs, it will include in MICRO GRANITE equipment (XYZ and turn axis) and a program will be manufactured.

土井精密ラップ株式会社  
Doi Precision Lapping Co., Ltd.

5-3-18 Omori-Minami Ota-Ku, Tokyo 143-0013 JAPAN

TEL : +81-03-5735-1337 FAX : +81-03-5735-1357

<http://www.micro-granite.co.jp>

**Wafercom 300** はベアウエハー対応の多機能な計測装置です。シリコン透過式変位センサーを用いてシリコンウエハー厚みを非接触で検出します。

本装置は測定時の揺れを最小限にする為、Y 軸（前後軸）及びθ 軸（回転軸）にはインド産黒御影石を使用した高精度なエアベアリングを採用しており、ウエハーの厚みデータを正確に検出する事が可能です。PCに取り込まれたデータを解析しグローバルフラットネス、サイトフラットネス、ワープ、ソリ及びエッジロールオフの形状評価ができます。

注) 本機、厚み測定にはウエハー表面粗さ約 # 2 0 0 0 メツシュ以上の鏡面が必要です。

注) サファイアウエハーの測定には光学プローブの変更が必要に成ります。

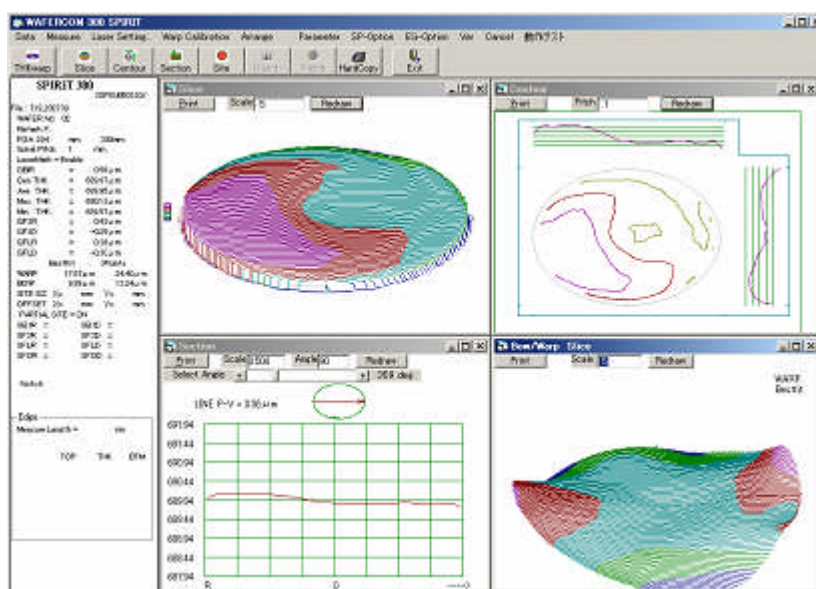
The **Wafercom 300** is a multifunctional measuring device for bare wafers.

It utilizes silicon transmission displacement sensors for contact less detection of the thickness of silicon wafers.

In order to minimize any shaking occurring during measurement, the Y-axis (front-back axis) and  $\theta$ -axis (rotational axis) of this device feature high-precision air bearings utilizing black granite from India, which ensures accurate detection of wafer thickness. By analyzing data exported to computer, the **Wafercom 300** is capable of assessing geometrical factors such as global flatness, site flatness, warp, sori, and edge roll-off.

Please note: To measure thickness, this device requires a mirrored surface with wafer surface roughness of around #2000 mesh or greater.

Please note: Measurement of sapphire wafer will require changing over to an optical probe.



Example of Analysis

《仕様 Specifications》	グローバル・フラットネス (Global flatness)	ソリ (Sori) エッジ (Roll-off)
ウエハーサイズ	Wafer Diameter	300 mm
検出器	Sensor	CHR-IT (CHR-E)
表示部	Display	CHR-IT
分解能	Resolution	0.2 $\mu$ m
検出範囲	Range	40~3500 $\mu$ m
繰り返し精度	Resolution	0.2 $\mu$ m
対称表面	Surface	鏡面のみ(only polished surface)
定義	Parameter	鏡面/粗面 (All surface)
		Sori
		L-ROA P-ROA
空気源	Air Pressure	
電源	Rated power	
装置の大きさ	Dimensions	
重量	Weight	
	0.4MPa Dry air	
	AC110V	
	600(W)×800(D)×1400(H)mm	
	300kg	
	GBIR/D GFLR/D GF3R/D	
	SBIR/D SFLR/D SF3R/D SFQR/D	